

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局



(43) 国際公開日  
2005 年 6 月 30 日 (30.06.2005)

PCT

(10) 国際公開番号  
WO 2005/059000 A1

- (51) 国際特許分類: C08G 59/00, C08L 71/02 (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2004/018350
- (22) 国際出願日: 2004 年 12 月 9 日 (09.12.2004)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:  
特願 2003-421662  
2003 年 12 月 18 日 (18.12.2003) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社カネカ (KANEKA CORPORATION) [JP/JP]; 〒5308288 大阪府大阪市北区中之島三丁目 2 番 4 号 Osaka (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 安藤克浩 (ANDO, Katsuhiko) [JP/JP]; 〒6740067 兵庫県明石市大久保町大久保町 9 9 6-1 0 3 Hyogo (JP). 幸光新太郎 (KOMITSU, Shintaro) [JP/JP]; 〒6760074 兵庫県高砂市梅井 2 丁目 3-1 5 Hyogo (JP).
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:  
— 国際調査報告書
- 2 文字コード及び他の略語については、定期発行される各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: CURABLE COMPOSITION

(54) 発明の名称: 硬化性組成物

(57) Abstract: A curable composition containing a polyoxypolypropylene polymer having reactive silicon-containing groups. It has reduced surface tackiness while retaining the intact applicability, strength, adhesion, and appearance. An embodiment of the curable composition is characterized by comprising (A) 100 parts by weight of a polyoxypolypropylene polymer having reactive silicon-containing groups, (B) 0.1 to 20 parts by weight of a silane coupling agent, (C) 0.1 to 80 parts by weight of an epoxidized compound, (D) 0.1 to 60 parts by weight of a tertiary amine, and (E) 0.1 to 30 parts by weight of a primary or secondary amine having a melting point of 20°C or higher.

(57) 要約: 本発明は、反応性ケイ素基含有ポリオキシプロピレン系重合体を用いた硬化性組成物の塗布作業性や強度、接着性、意匠性を低下させることなく表面タックを改善することを目的とする。解決手段の一態様として、(A) 反応性ケイ素基含有ポリオキシプロピレン系重合体 100 重量部、(B) シランカップリング剤 0.1 ~ 20 重量部、(C) エポキシ基含有化合物 0.1 ~ 80 重量部、(D) 3 級アミン 0.1 ~ 60 重量部、(E) 融点 20°C 以上の 1 級または 2 級アミン 0.1 ~ 30 重量部からなることを特徴とする硬化性組成物が挙げられる。

WO 2005/059000 A1